

388383-2026 - Kompetizzjoni

Il-Ġermanja – Tagħmir tal-laboratorju, ottiku u ta' preċiżjoni (minbarra nuċċalijiet) – Kauf einer DRIE/ RIE-Anlage (Plasmaätzenanlage)

OJ S 107/2026 05/06/2026

Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard

Provvisti

1. Xerrej

1.1. Xerrej

Isem uffiċjali: Westsächsische Hochschule Zwickau

Email: Beschaffungswesen@whz.de

Tip legali tax-xerrej: Korp irregolat bil-liġi pubblika, ikkontrollat minn awtorità reġjonali

Attività tal-awtorità kontraenti: Edukazzjoni

2. Proċedura

2.1. Proċedura

Titlu: Kauf einer DRIE/ RIE-Anlage (Plasmaätzenanlage)

Deskrizzjoni: Kurze Beschreibung: Anschaffung einer neuen DRIE/ RIE-Anlage

(Plasmaätzenanlage) - mit Software- und Anlagensteuerung inklusive Installation und

Einweisung Bestehend aus: DRIE/ RIE-Anlage, Substratelektrode, Kantenschutz der Wafer während der Ätzung, Notching-Kontrolle/ Reduktion der Strukturabweichung beim Ätzstopp auf Dielektrika, Endpunktdetektion, Software- und Anlagensteuerung, Verpackung / Transport / Abladen / Einbringen / Installation einschließlich Inbetriebnahme und Schulung Beschreibung der Beschaffung (Art und Umfang der Dienstleistung bzw. Angabe der Bedürfnisse und Anforderungen) Neue DRIE/ RIE-Anlage inkl. Zubehör für die Forschung an der WHZ mit folgenden Anforderungen: 01 1 RIE / DRIE-Anlage Plasmaätzenanlage für plasmachemisches, reaktives Silizium-Tiefenätzen (?500µm) mittels des Bosch-Prozesses (gas chopping process) und RIE von dünnen Dielektrika- Schichten (?2µm). - Die Anlage muss die Verarbeitung von 100mm Wafern mit und ohne Primary-Flat, sowie mit und ohne Secondary-Flat erlauben. - Die Anlage muss die Verarbeitung von 150mm Wafern mit und ohne Primary-Flat, mit und ohne Secondary-Flat oder auch mit und ohne Notch erlauben. - Das im DRIE-Modus mögliche Siliziumabtragsvolumen pro Zeiteinheit liegt bei bis zu ca. 2,5 mm³/s, das Wärmemanagement ist entsprechend auszulegen. Die exakten zu erfüllenden Prozessparameter sind der Spezifikationstabelle im Punkt "Geforderte Prozessparameter und deren Überprüfbarkeit" zu entnehmen. - Die Anlage muss über eine separate Beschickungskammer (Vakuumschleuse, Loadlock) verfügen, die es zulässt die spezifizierten Wafer, ohne ein Belüften der Prozesskammer gegen Atmosphäre zu laden. - Der Probenchuck / Substratelektrode muss über eine He-Rückseitenkühlung für die Substrate verfügen. Es muss zudem eine Vorrichtung zur Detektion von He-Lecks in Richtung Prozesskammer beim Ätzprozess, z.B. durch Waferbruch, vorhanden sein. - Via Mass-Flow-Controller geregelte Gaslinien für folgende Prozessgase müssen vorhanden sein: o C₄F₈ o SF₆ o O₂ o CHF₃ o Ar o CF₄ - Um parasitäre Abscheidung, z.B. von Fluorpolymeren, zu vermeiden muss das System über einen aktiv geheizten Prozesskammer-Liner (?120 °C) verfügen. - Alle zum RIE- und DRIE-Betrieb nötigen Anlagenbestandteile müssen Lieferbestandteil der Anlage sein, hierzu zählen beispielsweise, aber nicht abschließend: o Prozesskammer o Gestell / Korpus inkl. nötige Racks und Steuerschränke o Anlagen-Steuerung inkl. Eingabegeräte und Monitore o

Plasmaanregung / ICP Quelle mit automatisierter Matching-Unit oder Generatoren mit integrierter HF-Abstimmung o Druckmessung o Pumpsystem - Die Anlage muss für den Einbau in einem ISO 14644-1, Klasse ISO 5 Reinraum geeignet sein, Pumpsysteme können in einem Servicebereich untergebracht werden. - Die maximalen Abmessungen der Anlage dürfen inkl. notwendiger Serviceflächen maximal Höhe x Breite x Länge, 2,6m x 0,9m x 2,4m betragen. - Die zu liefernde Anlage muss über eine CE-Kennzeichnung des Gesamtsystems verfügen. Dies inkludiert die Einhaltung aller für das Anlagenkonzept einschlägigen Richtlinien, mindestens jedoch: - Richtlinie 2006/42/EG bzw. bei Lieferung ab dem 20.01.2027 Verordnung (EU) 2023/1230 - Low Voltage Directive - 2006/95/EC - EMC Directive - 2004/108/EC - Das System muss ausschließlich mit den genannten Prozessgasen, gasförmigem Helium, gasförmigem Stickstoff, Druckluft, Abluft, Kühlwasser und Elektroenergie betrieben werden. Zusätzliche Medien, wie z.B. Flüssighelium, Flüssigstickstoff oder Trockeneis dürfen nicht zum Betrieb nötig sein. - Die ICP-Quelle muss in einem Bereich von 120W bis 5000W oder weiter betreibbar sein, wobei bei einem weiteren Bereich der genannte Bereich inkludiert sein muss. 02 1 Substratelektrode Zur Probenhalterung wird aus Gründen der Homogenität und mechanischen Belastung der Wafer eine elektrostatische Klemmung gefordert. e-Chuck: - Die Substratelektrode muss für die Verarbeitung aller genannten Wafergeometrien (100 und 150mm) geeignet sein oder die entsprechende Anzahl an Substratelektroden für die Bearbeitung der genannten Wafergrößen müssen Lieferbestandteil sein. o Im Falle der Notwendigkeit des Tausches von Teilen zur Umrüstung zwischen den Wafergrößen sind, insofern nötig oder vorgeschrieben, alle etwaigen Verschleißteile (Dichtstoffe...) für eine 50-fache Umrüstung im Lieferumfang zu integrieren. - Falls für das Erreichen der geforderten Parameter ein Heater / Chiller nötig ist, muss dieser inkl. der eventuell nötigen Integration und Steuerung Lieferbestandteil sein. 03 1 Kantenschutz der Wafer während der Ätzung Es ist für den Schutz der Waferränder (z.B. bei der Verwendung Photoresistmasken) eine Kantenabdeckung (edge protection) vorzusehen. - Der Kantenschutz muss für die Verarbeitung aller genannten Wafergeometrien (100 und 150mm) geeignet sein oder über die Verwendung von Carriern / Adaptern oder Bauteiltausch die Verarbeitung zulassen. - Sind Zusatzteile für die Verarbeitung aller genannten Wafergeometrien nötig, müssen alle zur Umrüstung nötigen Teile Lieferbestandteil der Anlage sein. - Sind zur Umrüstung zwischen den Wafergeometrien Verschleißteile nötig oder vorgeschrieben sind diese für eine 50-fache Umrüstung im Lieferumfang zu integrieren. - Der Kantenschutz muss nach seiner Installation im Ätzbetrieb ohne Öffnen der Prozesskammer wirksam werden. - Ist der Kantenschutz ein Verschleißteil, z.B. ein Quarzglas-Ring, sind 2 Stück je benötigter Ausführung als Lieferbestandteil zu integrieren. 04 1 Notching-Kontrolle / Reduktion der Strukturabweichung beim Ätzstopp auf Dielektrika Um das sog. Notching bei der Ätzung von silicon on insulator (SOI) Strukturen und dem Stopp auf Dielektrikamembranen zu minimieren, ist die Substratelektrode mit einem gepulsten kHz Generator zu betreiben oder ein gleichwertiges Verfahren zur Vermeidung des so genannten Notchings einzusetzen.

Identifikatur tal-proċedura: b0cb9d46-0047-4223-b712-26d0ff3227ca

Identifikatur intern: OV 09-26

Tip ta' proċedura: Miftuħa

Il-proċedura hija aċċellerata: le

2.1.1. Għan

Natura tal-kuntratt: Provvisti

Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 38000000 Tagħmir tal-laboratorju, ottiku u ta' preċiżjoni (minbarra nuċċalijiet)

Klassifikazzjoni addizzjonali (cpv): 42990000 Makkinarju varju għal skopijiet speċjali, 31712330 Semi-kunduttur

2.1.2. Post tal-prestazzjoni

Indirizz postali: Kornmarkt 1

Belt: Zwickau

Kodiċi postali: 08056

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Zwickau (DED45)

Pajjiż: Il-Ġermanja

Informazzjoni addizzjonali: Westsächsische Hochschule Zwickau Hochtechnologiezentrum
Peter-Breuer-Str. 5-11 08056 Zwickau Deutschland

2.1.4. Informazzjoni ġenerali

Informazzjoni addizzjonali: #Bekanntmachungs-ID: CXP4D4ZMZEU#

Baži legali:

Direttiva 2014/24/UE

vgv -

2.1.6. Raġunijiet għall-eskluzjoni

Sors tal-motivi għall-eżklussjoni: Dokument tal-Akkwist

5. Lott

5.1. Lott: LOT-0001

Titlu: Kauf einer DRIE/ RIE-Anlage (Plasmaätzanlage)

Deskrizzjoni: - Die Funktion ist innerhalb der Inbetriebnahme an Silizium-Wafern mit einer Dicke von mindestens 380µm mit einem Ätzstopp auf 1500-2500nm thermischem Siliziumdioxid nachzuweisen. Der Nachweis erfolgt durch eine Überätzung von rechnerisch >10µm nach Erreichen des Endpunktes. - Als Ätzmaske bei diesem Abnahmetest dient ebenfalls 1500-2500nm thermisches Siliziumdioxid mit geöffneten Strukturen von 250x250µm (+/-10µm) in einem x / y-Pitch von 3000µm, gleichverteilt über den Wafer. - Die Wafer werden durch den Auftraggeber im Rahmen des SAT (Anlagenabnahme am Bestimmungsort) zur Verfügung gestellt. - Die Parameter sind bei einem 100mm Wafer, innerhalb des 90mm durchmessenden Kernbereichs und bei einem 150mm Wafer innerhalb des 140mm Kernbereichs nachzuweisen (je 5mm Randausschluss). - Die durchschnittliche Ätzrate, ab dem Start der Ätzung, muss bei dem Test min. 10µm/min betragen. - Die einseitige Abweichung von der Tangente der Ätzflanke darf bei keiner Struktur mehr als 10µm betragen. 05 1 Endpunktdetektion Die Prozessüberwachung und die Endpunktkontrolle muss über die optische Analyse der Plasmaemission anhand der charakteristischen Emissionslinien erfolgen. Es muss mindestens der Bereich von 250 - 850nm zur Auswertung zugänglich sein. - Die Endpunktdetektion ist in Auflösung und Empfindlichkeit so zu realisieren, dass der Endpunkt auch bei geringen offenen Flächen <5% sicher detektiert wird. - Es sollen mindestens folgende Endpunktdetektionen bei max. 5% offener Fläche möglich sein: o Silizium-Ätzung mit Endpunkt auf SiO₂ o Silizium-Ätzung mit Endpunkt auf Al o Silizium-Ätzung mit Endpunkt auf Photoresist o SixNy-Ätzung mit Endpunkt auf SiO₂ o SixNy-Ätzung mit Endpunkt auf Si o SiO₂-Ätzung mit Endpunkt auf Si 06 1 Software und Anlagensteuerung - Die Bediensoftware muss mindestens die folgenden Nutzerniveaus enthalten: o Bediener dem nur der Start bereits vorhandener Rezepte gestattet ist. o Ingenieur dem zusätzlich das Erstellen und Ändern von Rezepten gestattet ist (wahlweise mit Passwortschutz durch den Kunden). o Service den zusätzlich die manuelle Steuerung der Anlage und die Umgehung von Interlocks gestattet ist (wahlweise mit Passwortschutz durch den Kunden). - Wird als Betriebssystem Microsoft Windows eingesetzt, muss dieses auf Version 11 oder 10 LTSC basieren. - Die Bediensoftware muss einen automatisierten Leckagetest und MFC-Funktionstest enthalten. -

Das Steuerungskonzept muss auf einer Direct One-to-one Verbindung zu den Sensoren und Aktoren basieren (Ein Steuerungskanal zu einem Sensor oder Aktor) - Es muss eine kanalweise Diagnostik für die Steuerungskanäle vorhanden (on/off) und die entsprechende Status Informaton (OK, Kurzschluss, Unterbrechung) - Das Datalogging muss in Intervallen ? 250 ms möglich sein. - Für die genaue Kontrolle der zeitlichen Abfolge in den Prozessen müssen Prozessschritte bis zu einer Gesamtlänge von ? 10 ms definiert werden können. - Die Anzahl der anlegbaren Prozessrezepte soll nicht anlagenseitig auf einen Wert kleiner 5000 begrenzt sein. - Die Softwarelösung muss SEMI E95 konform gestaltet sein. 07 1 Installation /Schulung - Installation der Soft- und Hardware - Grunds Schulung der Anwender (Bedienung der Soft- und Hardware, Umgang mit Betriebsmitteln, In- und Außerbetriebnahme, Wartung) - Zur Anlage ist ein Bedienerhandbuch, Servicehandbuch und Stromlaufplan in deutscher oder englischer Sprache zu liefern. 08 1 Geforderte Prozessparameter und deren Überprüfbarkeit Der Anbieter muss bestätigen, dass er über ein Applikationslabor verfügt, welches mittels öffentlicher Verkehrsmittel, einem PKW oder der Kombination beider innerhalb von 12h vom Bestimmungsort aus erreichbar ist. Innerhalb dieses Applikationslabors muss mindestens eines der angebotenen Systeme (mit den nicht optionalen Grundfunktionalitäten) betrieben werden und für Anlagentests zur Verfügung stehen. Zudem behält sich der Käufer vor, die angegebenen Parameter an dieser Anlage innerhalb des Evaluationsprozesses der Angebote vor Ort bei dem Anbieter zu überprüfen. Auf Anfrage muss diese Überprüfung innerhalb einer Woche nach Ankündigung möglich sein. Geforderte Prozessparameterkombinationen lt. Leistungsbeschreibung. Die geforderten Prozesse mit den entsprechenden Parametern sind in geeigneter Form (z.B. wie die innerhalb der in dieser Ausschreibung im Leistungsverzeichnis FB 27 verwendete Tabelle) dem Angebot beizufügen. 09 1 Verpackung / Transport / Abladen / Einbringen / Leistungsort: Westsächsische Hochschule Zwickau Hochtechnologiezentrum Peter- Breuer-Straße 5-11 08056 Zwickau Lieferung nach Incoterms 2020 DAP oder DDP, Fracht bis zur ebenerdig und rollend mit erreichbaren Entladestelle an der Lieferzufahrt Dr.- Friedrichs-Ring 2C, 08056 Zwickau, Deutschland Lieferzeit: max. 50. KW nach Beauftragung Identifikatur intern: OV 09-26

5.1.1. Għan

Natura tal-kuntratt: Provvisti

Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 38000000 Tagħmir tal-laboratorju, ottiku u ta' preċiżjoni (minbarra nuċċalijiet)

Klassifikazzjoni addizzjonali (cpv): 42990000 Makkinarju varju għal skopijiet speċjali, 31712330 Semi-kundutturi

Għażliet:

Deskrizzjoni tal-għażliet: 1.) Optionale Nachrüstbarkeit eines Cryoprozesses 2.) Optionale Erweiterbarkeit zu einem Clustersystem

5.1.2. Post tal-prestazzjoni

Indirizz postali: Kornmarkt 1

Belt: Zwickau

Kodiċi postali: 08056

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Zwickau (DED45)

Pajjiż: Il-Ġermanja

Informazzjoni addizzjonali: Westsächsische Hochschule Zwickau Hochtechnologiezentrum Peter-Breuer-Str. 5-11 08056 Zwickau Deutschland

5.1.3. Tul ta' żmien stmat

Tul ta' żmien: 50 Ġimagħtejn

5.1.6. Informazzjoni ġenerali

Parteċipazzjoni riżervata:

Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.

Proġett ta' akkwist iffinanzjat kompletament jew parzjalment mill-Fondi tal-UE

L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): le

Dan l-akkwist huwa adattat ukoll għall-intrapriżi żgħira u ta' daqs medju (SMEs): le

Informazzjoni addizzjonali: zu 1.) Es sollte möglichst die Nachrüstbarkeit einer Substratelektrode für Cryo-Prozesse gegeben sein, welche Prozessführungen bis zu einer Substrattemperatur von -150°C zulässt. Diese Option darf die Nachrüstung einer mechanischen Substratklemmung und den Einsatz von Zusatzmedien (z.B. Flüssigstickstoff) nötig machen. zu 2.) Optionaler späterer Ersatz des Loadlocks (Waferschleuse) durch ein Transfersystem bei welchem eine Waferkassettenstation und min. 2 weitere Prozessmodule (z. B. PE-CVD, ALD oder RIE/ DRIE) angeschlossen werden können, um die Anlage funktionell zu erweitern.

5.1.7. Akkwist strateġiku

Għan tal-akkwist strateġiku: Ebda akkwist strateġiku

5.1.9. Kriterji tal-għażla

Sors tal-kriterji ta' għażla: Avviż

Kriterju: Ghodda, impjanti jew apparat tekniku

Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Nachweis über Vorhandensein eines Applikationslabors bei Bieter

5.1.10. Kriterji tal-għoti

Kriterju:

Tip: Prezz

Isem: Preiskriterium

Deskrizzjoni: Preiskriterium

Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta' ponderazzjoni (punti, eżatt)

Numru tal-kriterju għall-għoti: 30

Kriterju:

Tip: Kwalità

Isem: Erfüllung der Leistungsparameter

Deskrizzjoni: Erfüllung der Leistungsparameter

Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta' ponderazzjoni (punti, eżatt)

Numru tal-kriterju għall-għoti: 60

Kriterju:

Tip: Kwalità

Isem: Lieferzeit

Deskrizzjoni: Lieferzeit

Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta' ponderazzjoni (punti, eżatt)

Numru tal-kriterju għall-għoti: 10

5.1.11. Dokumenti tal-akkwist

Lingwi li bihom id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli uffiċjalment: Ġermaniż

Skadenza biex tintalab informazzjoni addizzjonali: 03/07/2026 23:59:59 (UTC+02:00) Hin tal-

Ewropa tal-Lvant, Hin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: <https://www.dtv.de/Satellite/notice/CXP4D4ZMZEU/documents>

Mezz ta' komunikazzjoni ad hoc:

5.1.12. Termini tal-akkwist

Termini tas-sottomissjoni:

Sottomissjoni elettronika: Meħtieġa

Indirizz għas-sottomissjoni: <https://www.dtv.de/Satellite/notice/CXP4D4ZMZEU>

Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-parteciċipazzjoni: Ġermaniż

Katalogu elettroniku: Mhux permessa

Varjanti: Mhux permessa

L-offerenti jistgħu jifgħu aktar minn offerta waħda: Mhux permessa

Skadenza biex jintlaqgħu l-offerti: 10/07/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant,

Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

Perjodu waqt li l-offerta għandha tibqa' valida: 9 Ġimagħtejn

Informazzjoni li tista' tiġi ssupplimentata wara l-iskadenza għas-sottomissjoni:

Fid-diskrezzjoni tax-xerrej, id-dokumenti kollha neqsin relatati mal-offerent jistgħu jiġu ppreżentati aktar tard.

Informazzjoni addizzjonali: Der Auftragnehmer behält sich vor, Unterlagen zur Aufklärung nachzufordern.

Informazzjoni dwar il-ftuħ pubbliku:

Data tal-ftuħ: 10/07/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

Termini tal-kuntratt:

L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta' programmi ta' impjiegi protetti: Le

Fatturazzjoni elettronika: Meħtieġa

Se tintuża l-ordni elettronika: le

Se jintuża l-pagament elettroniku: le

5.1.15. Tekniki

Ftehim qafas:

Ebda ftehim ta' qafas

Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri:

Ebda sistema dinamika ta' xiri

5.1.16. Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami

Organizzazzjoni tar-rieżami: Vergabekammer des Freistaates Sachsen

Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist:

Westsächsische Hochschule Zwickau

Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami: Vergabekammer des Freistaates Sachsen

Organizzazzjoni li tirċievi t-talbiet għall-parteciċipazzjoni: Westsächsische Hochschule Zwickau

8. Organizzazzjonijiet

8.1. ORG-0001

Isem uffiċjali: Westsächsische Hochschule Zwickau

Numru tar-registrazzjoni: 14-1215011WHZ01-34

Indirizz postali: Kornmarkt 1

Belt: Zwickau

Kodiċi postali: 08056

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Zwickau (DED45)

Pajjiż: Il-Ġermanja

Email: Beschaffungswesen@whz.de

Telefown: 03755361131

Indirizz tal-internet: <https://www.whz.de>

Profil tax-xerrej: <https://www.whz.de>

Rwoli ta' din l-organizzazzjoni:

Xerrej

Korp ċentrali għall-akkwisti li jagħti l-kuntratti pubbliċi jew li jikkonkludi ftehimiet qafas għal xogħlijiet, provvisti jew servizzi maħsuba għal xerrejja oħra

Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist

Organizzazzjoni li tirċievi t-talbiet għall-partecipazzjoni

8.1. ORG-0002

Isem uffiċjali: Vergabekammer des Freistaates Sachsen

Numru tar-registrazzjoni: ohne

Belt: Leipzig

Kodiċi postali: 04013

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Leipzig, Kreisfreie Stadt (DED51)

Pajjiż: Il-Ġermanja

Email: vergabekammer@lds.sachsen.de

Telefown: +49 03419773800

Rwoli ta' din l-organizzazzjoni:

Organizzazzjoni tar-rieżami

Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami

8.1. ORG-0003

Isem uffiċjali: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Numru tar-registrazzjoni: 0204:994-DOEVD-83

Belt: Bonn

Kodiċi postali: 53119

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Pajjiż: Il-Ġermanja

Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telefown: +49228996100

Rwoli ta' din l-organizzazzjoni:

TED eSender

Informazzjoni dwar l-avviż

Identifikatur/verżjoni tal-avviż: 2ccf26c1-6b0a-47ce-8228-ad9b97611ff8 - 01

Tip ta' formola: Kompetizzjoni

Tip ta' avviż: Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard

Sottotip tal-avviż: 16

Data ta' meta ntbagħat l-avviż: 04/06/2026 09:00:02 (UTC+02:00) Hin tal-Ewropa tal-Lvant, Hin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

Lingwi li bihom dan l-avviż huwa disponibbli uffiċjalment: Ġermaniż

Numru tal-pubblikazzjoni tal-avviż: 388383-2026

Numru tal-ħarġa tal-ĠU S: 107/2026

Data tal-pubblikazzjoni: 05/06/2026